

MicroSense® CSW1

晶圆测量系统

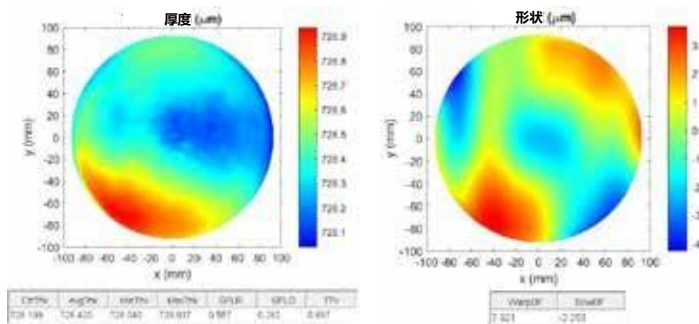
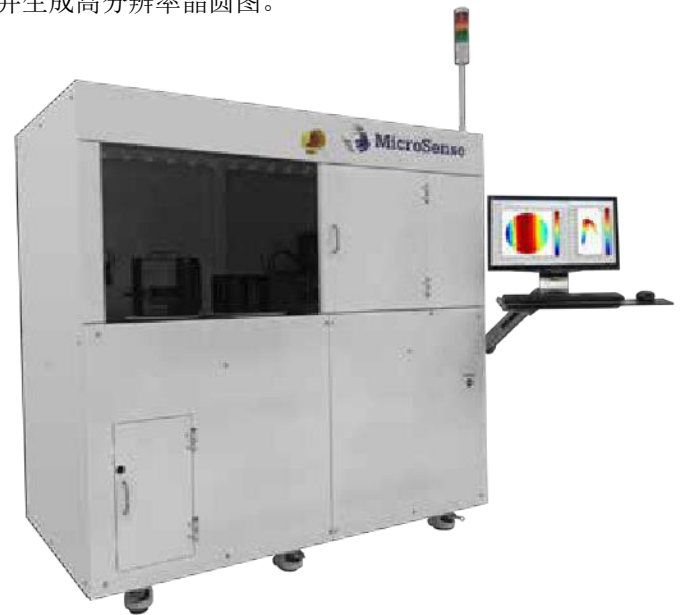
150mm 和 200mm 晶圆的几何量测

针对直径为150mm 和 200mm 的薄膜、图案与裸晶圆进行自动的非接触式测量

MicroSense CSW1测量系统使用具有纳米级厚度分辨率的非接触式电容传感器在半导体晶圆上进行高速全晶圆几何测量。该系统根据SEMI标准测量晶圆的厚度、平整度、弯曲度和翘曲度。该系统专为最大限度地提供多功能性而设计，可以测量150mm和200mm直径的晶圆。在每个晶圆上测量超过120,000个数据并生成高分辨率晶圆图。

关键性能

- 系统在测量每片晶圆之前和之后都进行自动校准以获得最佳的可重复性
- 晶圆加载到系统中后，在测量过程中通过精密的直接驱动空气轴承X-Y平台自动定位
- MicroSense UltraMap 测量软件提供全系列的SEMI标准晶圆厚度/平面度/形状测量，其中包括局部和全方位平整度
- 提供2D和3D晶圆图



通过全晶圆测绘提供晶圆厚度、晶圆形状和全晶圆应力



纳米级分辨率的电容传感器

KLA 支持

保持系统产能是KLA良率优化解决方案不可或缺的一部分。该领域内的工作包括系统维护、全球供应链管理、降低成本和缓解系统过时、系统搬运、性能和产能提升以及认证设备的转售。

©2021 KLA 公司。所有品牌或产品名称可能是其各自公司的商标。KLA保留更改硬件或软件规格的权力，恕不另行通知

KLA Corporation
One Technology Drive
Milpitas, CA 95035
www.kla.com

美国印刷

2021年7月20日第1.0版